

맞춤형 Ptfе 웨이퍼 세척 바스켓 반도체 실리콘 웨이퍼 홀더 저배경 불소수지 카세트

품목 번호: PL-CP266



소개

반도체 공정을 위한 고순도 맞춤형 PTFE 웨이퍼 세척 바스켓입니다. 저배경 미량 분석 및 강력한 내화학성을 위해 설계된 이 맞춤형 불소수지 카세트는 중요한 클린룸 환경 및 산업 실험실에서 실리콘 웨이퍼의 용해 및 오염 없는 처리를 보장합니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
RCA 세척 (SC-1/SC-2)	실리콘 표면에서 유기 오염물, 얇은 산화막 및 이온성 불순물 제거.	과산화수소 및 암모늄 수산화물 혼합물에 대한 높은 저항성.
불산 에칭	이산화규소 증 및 표면 패시베이션의 선택적 제거.	석영 또는 유리 반송기를 분해시킬 수 있는 HF에 대한 완전한 내성.
Piranha 에칭 처리	황산 및 과산화물을 사용한 중유기 잔류물 및 포토레지스트의 강력한 제거.	고발열 및 산화 환경에서 구조적 무결성 유지.
포토리소그래피 지원	포토리소그래피 소재의 현상, 제거 및 세척 중 웨이퍼 핸들링.	용제 저항성은 스트리퍼에 노출될 때 반송기가 팽창하거나 부드러워지지 않도록 보장합니다.
CMP 후 린싱	연마 슬러리를 제거하기 위한 화학 기계적 평탄화 후 웨이퍼의 중요한 세척.	지입자 발생 표면은 웨이퍼가 연마 단계 후에도 깨끗하게 유지되도록 보장합니다.
화합물 반도체 준비	고급 광전자 공학을 위한 GaAs, GaN 및 InP 웨이퍼의 전문 세척.	부드럽고 정밀한 슬롯 지지대는 취성 화합물 소재의 손상을 방지합니다.
초음파/메가소닉 세척	탈이온수에서 서브미크론 입자를 제거하기 위한 고주파 진동 세척.	소재 특성으로 과도한 진동을 감쇠시키면서 효과적인 에너지 전달을 가능하게 합니다.

매개변수 범주	PL-CP266 사양 세부 정보
주요 소재	고순도 PTFE (폴리테트라플루오로에틸렌) / PFA (퍼플루오로알콕시)
제조 방법	고정밀 CNC 가공 (맞춤 제작)
웨이퍼 크기 호환성	완전 맞춤화 가능 (일반 크기: 2", 3", 4", 6", 8", 12" 또는 맞춤 치수)
슬롯 구성	공정 요구 사항에 따른 맞춤 간격, 깊이 및 수량
핸들 설계	고정식, 분리식 또는 통합 리프팅 아이 사용 가능 (맞춤화 가능)
화학적 저항성	우수함 (모든 산, 염기 및 유기 용제와 호환 가능)
작동 온도 범위	-200°C ~ +260°C (소재 한계; 응용 분야별)
표면 거칠기	최소 입자 포집을 위한 제어된 CNC 마감
미량 원소 배경	저수준 미량 분석에 최적화 (저배경 요구사항 충족)
용출 프로파일	제로 용출 / 용출성 첨가제 없음 (무용출)